

2010 年年终总结

2005 年进入恒晨这个大家庭，伴随着恒晨的不断发展壮大，现在又即将走过 2010，迎来 2011 新的一年。在即将过去的一年中，我主要负责 SMT 工艺方面。也正是这一年，由于领导对生产工艺优化的重视与支持，使我能够充分发挥自己的能力，为公司工艺优化与成本的节约贡献出一份力量。在工作中，通过部门之间的沟通、和外部专员人员的探讨等，不但增加了自己的专业知识，且使自己的沟通协调能力进一步得到提升。通过公司组织的执行力培训等培训课程和平时恒晨企业文化的熏陶，使自己的责任心和工作积极性也得到了很大提升。但一些大客户验厂中出现的问题点，也反映出了我工作中的不足和需要提升的地方。如经验主义浓，工作的系统化、流程化欠缺；作为基层管理人员，现场管理的经验不足等。现就 2010 年工作做个回顾、总结。以便做的好的地方能够继续发扬，不足的地方能够做出改善，力争在 2011 年做的更好。

一：2010 年总结：

1、 生产工艺优化的参与与推动。

从今年年初开始，对我们生产中的 PCB 长期存在未改善的和一些新出的问题点：

如焊盘设计、拼板设计等问题做了全面的总结，并提出建议更改方案。各问题点通过《评估报告》的形式反馈给工程、开发。并根据我厂各种设备的具体特点总结《PCB 拼板规范要求》提供给公司 Layout 参考。通过随时和 Layout 工作人员沟通，确保拼板的合理性和对我们设备的适应性。

2、 SMT 各种作业标准和规范的制定。

通过借鉴和总结，并结合我们自身的生产、设备特点，制定《钢网的使用与管理规范》、《物料烘烤规范》、《回流焊温度设定规范》等作业规范。并对新进设备，如：X-RAY，锡膏测厚仪、AOI 等及时提供作业指导和操作规范，确保操作的规范性与安全性。

3、 生产中问题点的跟踪与处理，保证产品品质。

对板卡生产中出现的问题点及时分析原因并反馈、处理。如 32851 一度出现小料虚焊导致 PPM 上升现象，分析为 PCB 毛刺引起，及时要求供应商现场确认并一起探讨出处理方法。对其他一些内部作业问题导致的品质异常，也能做到及时指导与纠正。通过大家的一起努力，炉后 PPM 值由 09 年的平均 500PPM 左右到现在的 150PPM 左右。

4、 对设备的维护与保养。

对回流焊、AOI 等一些自己所负责的设备，做了易损件的及时配备与定期维护保养工作。对生产中出现的设备异常及时处理，保证生产的正常进行与设备的良好运转。

5、对工艺、AOI 技术员工作的指导与监督。

指导并协助 AOI 技术员进行软件升级和程序优化，减轻 QC 工作压力。通过工作中问题点的处理，培养工艺技术员分析问题和解决问题的能力。

二：2011 年规划

1、持续推动 SMT 生产工艺的优化工作。2011 年的工艺改进工作可能会更偏向于对专项问题的探讨与解决。可能每一个小的进步都需要较大的力气去解决。

2、提升为大客户服务的能力。对我们的工艺流程规范化、文件化。对技术员的工作职责也流程化、规范化。

3、进一步充实自己的专业能力与水平。增加对新进设备的熟悉、熟练程度。更深层次的去了解 SMT 工艺相关元素的性能与工作原理。如：锡膏的工作原理、PCB 的制作工艺等。为今后更好的工作提供保障。

4、SMT 品质的管控。对 SMT 生产中的问题点及时跟踪、反馈、处理。争取炉后 PPM 值在现有设备状况下控制在 100 以内。

5、设备的维护、更新。SMT 有 16 台回流焊，其中 8 台诺斯达的都出现不同程度老化、磨损。尤其是从恒光搬过来的四台，发热丝、马达、其他部件出现问题频繁。且有两台轨道变形已不能用、控温精度已达不到要求，需要做更全面的点检与较大的维护动作。

在公司战略方针的指引下，有领导的大力支持，有大家的齐心协力、共同努力我相信 2011 年我会做的更好；更相信 2011 年恒晨能够取得更辉煌的成绩。